

2018年 関西表面技術シンポジウム

ウェットプロセスを基盤とした材料開発ならびに解析技術の展開
電気鍍金研究会
表面技術協会関西支部
表面技術協会ウェットプロセス研究部会

電気鍍金研究会の「次世代めっき技術連携開発プロジェクト第4期」の中間報告会と表面技術協会関西支部の特別講演会を兼ねて表記のシンポジウムを開催いたします。

多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。

日時： 平成30年7月25日(水) 13:30~17:00
会場： 大阪鍍金会館 (〒537-0025 大阪市東成区中道3-1-14) JR環状線 玉造駅 下車徒歩5分
参加費： 会員 3,000円, 学生 1,000円, 非会員 6,000円 (いずれもテキスト代含む)
申込方法： 参加希望者は、申込み書に必要事項をご記入の上、7月6日(金)までにファックスでお申し込みください。なお、参加費は当日徴収いたします。
申込先： 電気鍍金研究会事務局 TEL/FAX 06-4259-6890
定員： 90名 (先着順)

プログラム

13:30-14:20 講演：「ウルトラファインバブルと低濃度オゾン水を融合した環境に優しいABS樹脂改質法」
(関東学院大学材料・表面工学研究所 田代雄彦)

近年話題のファインバブルと低濃度(1.5-2.0 mg/L)のオゾン水を融合し、汎用プラスチックへのめっき前処理法として適用できる事を見出した。本手法は現状使用されている有害な6価クロム(発癌性物質)を含むエッチング液の代替が期待できる。

14:20-14:30 休憩：

14:30-15:20 講演：「MEMSのためのめっき・電鍍技術」 ((地独)京都市産業技術研究所 永山富男)

MEMS技術の実用化には、トップダウン型とボトムアップ型のナノテクノロジーの融合による新たな微細加工技術の創出が不可欠である。今回、ボトムアップ型ナノテクノロジーであるめっき・電鍍技術のMEMS分野での活用について、これまでの事例と将来展望について述べる。

15:20-15:40 休憩：

15:40-17:00 ポスタープレゼンテーション (各2分間のショートプレゼンテーションを含む)：

1. 低水素脆性亜鉛系めっきの開発 (Ⅱ)
(広島工業大学) 日野 実
2. めっきにおける水素共析と水素誘起現象の解析
(兵庫県立大学) 八重真治, 福室直樹
3. 無電解めっき法によるインバー合金薄膜の開発
(京都市産業技術研究所) ○山本貴代, 永山富男, 中村俊博
4. 非晶質Cr-C合金めっきの平滑化および厚膜化
(大阪技術研・和泉センター) ○林 彰平, 中出卓男, 長瀧敬行
5. 水溶液からの遷移金属硫化物電析とリチウム二次電池への応用
(大阪技術研・森之宮センター) ○池田慎吾, 小林靖之, 藤原 裕
6. 水溶液電析法によるジルコニア構造体膜の作製
(大阪技術研・森之宮センター) 千金正也
7. ウェットプロセスによる機能性磁性薄膜の作製
(奈良工業高等専門学校) 藤田直幸

※ポスタープレゼンテーションは、発表時間中に発表者と聴講者が自由に質疑応答できます。「次世代めっき技術連携開発プロジェクト」の企業と研究者のマッチングのために活用ください。

FAX 送 信 票

平成 30 年 月 日

電気鍍金研究会 事務局 御中

FAX : 06-4259-6890

2018 年 関 西 表 面 技 術 シ ン ポ ジ ウ ム

ウェットプロセスを基盤とした材料開発ならびに解析技術の展開

参 加 申 込

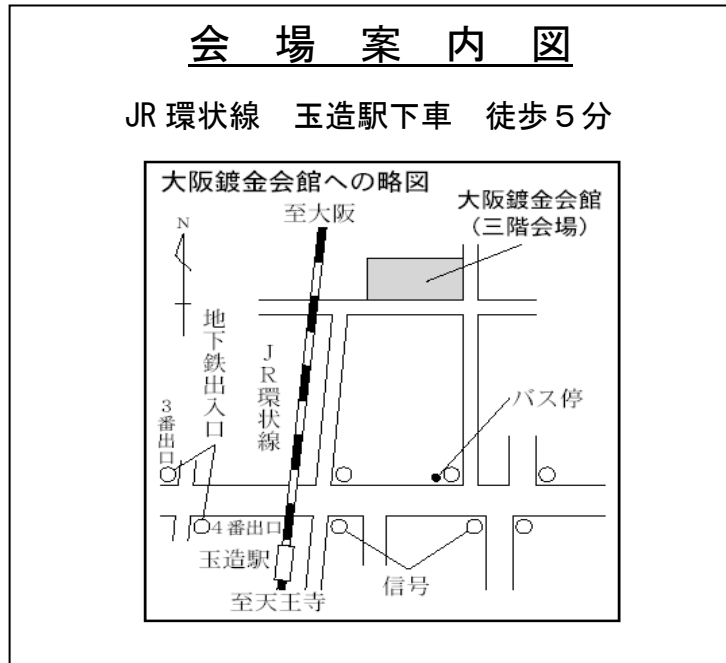
氏名 _____

社名/所属 _____ 部署 _____

TEL _____ FAX _____

会員資格 (該当するものを全てチェックして下さい)

電気鍍金研究会 表面技術協会 学生 会員外



申込先 : 電気鍍金研究会事務局 TEL/FAX 06-4259-6890

大阪市東成区中道 3-1-14 大阪鍍金会館内